

半导体

国产半导体设备零部件是否能真的迎来行业春天？

上周行情概览：

上周半导体行情跑输主要指数。上周申万半导体行业指数下降 3.32%，同期创业板指数上涨 1.10%，上证综指上涨 2.19%，深证综指上涨 1.29%，中小板指上涨 0.99%，万得全 A 上涨 1.25%。

半导体各细分板块整体下跌。半导体细分板块中，半导体材料板块上周下跌 2.4%，分立器件板块上周下跌 2.8%，半导体设备板块上周下跌 2.0%，半导体制造板块上周下跌 4.6%，封测板块上周下跌 2.4%，IC 设计板块上周下跌 3.6%，其他板块上周下跌 2.1%。

我们坚定看好半导体全年的结构性行情。此前我们在报告《结构性行情持续，6 大细分赛道值得关注》2022.03.01 中提出“在产能持续紧缺的大背景下，我们持续看好全年板块的结构性行情，汽车电子、服务器芯片、特种 IC、材料设备、晶圆厂、IoT 芯片，6 大细分板块机会值得关注”，当前时点进入年报披露窗口期，相关公司业绩超预期或带来短期股价反应。

半导体设备销售额创新高，市场关注点逐渐从设备向设备上游转移。2021 年半导体设备的全球销售额预计同比增长 45%，增至 1030 亿美元，创历史新高。2021 年来半导体产能持续短缺，各大晶圆厂正在加快扩大产能，市场增长持续超出预期，2022 年全球半导体设备销售额有望达到 1140 亿美元。在全球半导体设备市场景气向上的背景下，其供应链相关企业有望受益。国内半导体设备企业实力的壮大，驱动国内半导体设备零部件产业的发展，零部件的国产化或将成为一种趋势。

设备零部件国产化进程持续推进，相关企业能否真的迎来行业春天？国际政治不确定性持续提高，半导体全产业链自主化重要性凸显。半导体设备零部件一方面受到下游晶圆厂扩产拉动设备采购需求的影响，同时国产半导体设备厂商也有零部件国产化的需求，看似行业增长逻辑清晰，考虑到设备零部件种类繁多，国产设备零部件是否能真的迎来行业春天，还要取决于设备厂商的国产化比率提升速度，以及相关产业链公司的技术实力。

建议关注：

- 1) 半导体材料设备：有研新材/雅克科技/沪硅产业/华峰测控/北方华创/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份；
- 2) IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；
- 3) 晶圆代工：华虹半导体/中芯国际；
- 4) 半导体设计：东微半导体/复旦微电/圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导体/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/艾为电子/龙芯中科/海光信息；

风险提示：疫情继续恶化、产业政策变化、国际贸易争端加剧、下游行业需求不及预期。

证券研究报告

2022 年 04 月 05 日

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)

上次评级 强于大市

作者

潘暕 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517070005
panjian@tfzq.com

程如莹 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521110002
chengruiying@tfzq.com

骆奕扬 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:关注华虹拟科创板上市带来的相关机会》 2022-03-27
- 2 《半导体-行业研究周报:聚焦两大主线:新产品升级+新能源需求高景气》 2022-03-20
- 3 《半导体-行业研究周报:汽车芯片:智能化+电动化浪潮迭起,缺芯或将持续全年》 2022-03-13

内容目录

1. 每周谈：晶圆厂集中扩产，国产设备零部件有望受益	3
1.1. 半导体设备市场增长，推动供应链相关行业国产化	3
1.2. 晶圆产能增加，设备零部件国产化进程持续推进	4
2. 上周半导体行情回顾	5
3. 上周重点公司公告	7
4. 上周半导体重点新闻	10
5. 风险提示	11

图表目录

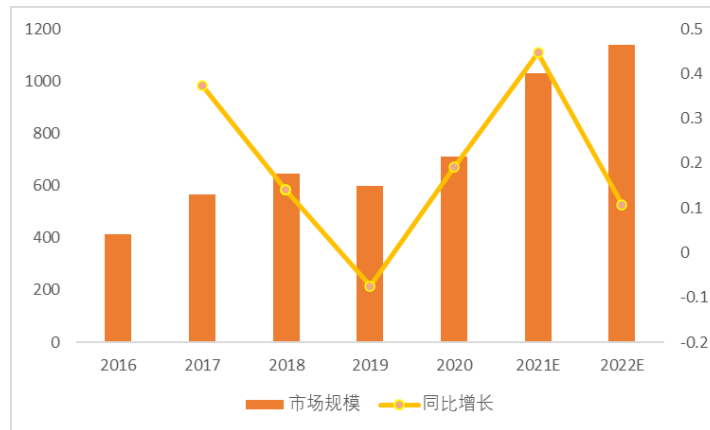
图 1：2016-2022E 全球半导体设备市场规模（亿美元）	3
图 2：全球半导体设备细分产品市场占比情况	3
图 3：光刻机厂商市场份额	4
图 4：刻蚀机厂商市场份额	4
图 5：大陆半导体制造产能分布	5
图 6：上周 A 股各行业行情对比（%）	6
图 7：上周子板块涨跌幅（%）	6
图 8：半导体子板块估值与业绩增速预期	6
表 1：半导体设备领域国内外竞争厂商（按类别）	4
表 2：主要晶圆代工厂商 2022 资本支出	4
表 3：上周半导体行情与主要指数对比	5
表 4：上周涨跌前 10 半导体个股	7

1. 每周谈：晶圆厂集中扩产，国产设备零部件有望受益

1.1. 半导体设备市场增长，推动供应链相关行业国产化

根据 SEMI 数据,2021 年半导体设备的全球销售额预计同比增长 45%，增至 1030 亿美元，创历史新高。由于半导体持续短缺，各大晶圆厂正在加快扩大产能，市场增长持续超出预期，2022 年全球半导体设备销售额有望达到 1140 亿美元。

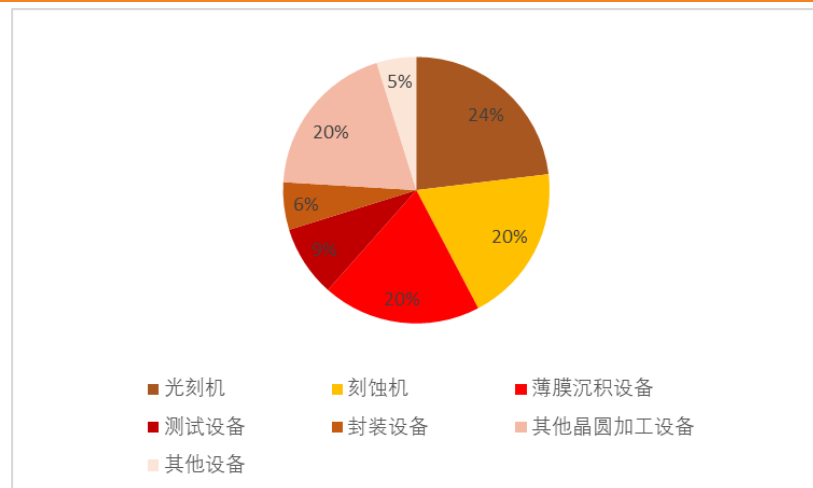
图 1：2016-2022E 全球半导体设备市场规模（亿美元）



资料来源：中商情报网，天风证券研究所

集成电路设备领域长期保持寡头垄断的市场格局，通常表现为 2-3 家行业龙头占在半导体制造各个环节所需设备的大部分市场份额，在对技术要求非常高的光刻机、薄膜沉积和刻蚀机这三大设备领域表现尤其明显。在集成电路制造过程中，光刻精度决定了元器件刻画的尺寸，刻蚀和薄膜沉积的精度则决定了实际加工后的结果和良率，这三大设备占据整个集成电路前道设备价值的近 70%。

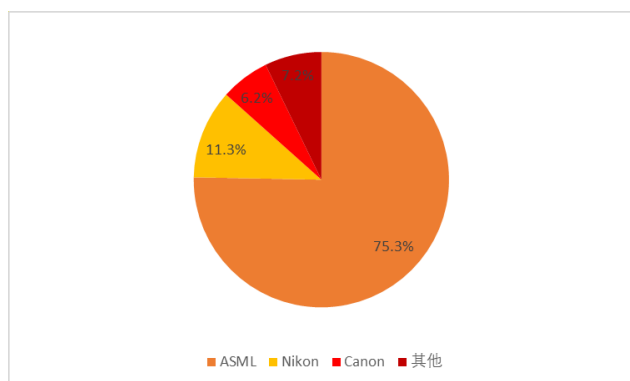
图 2：全球半导体设备细分产品市场占比情况



资料来源：中商情报网，天风证券研究所

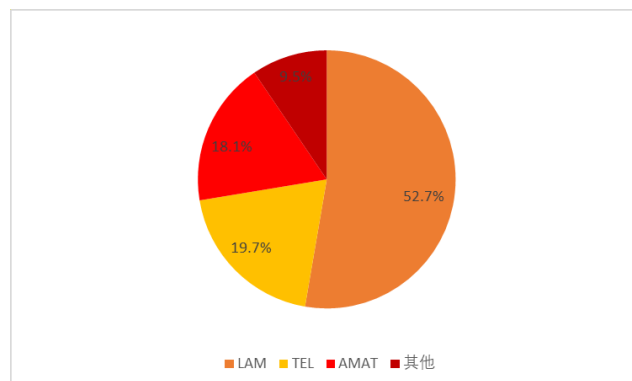
而在这三大领域中，ASML 独自垄断高端光刻机，泛林半导体 LAM 是刻蚀领域的龙头企业，AMAT 更是长年保持行业第一，在多领域都占用重要市场份额。

图 3：光刻机厂商市场份额



资料来源：产业信息网，天风证券研究所

图 4：刻蚀机厂商市场份额



资料来源：产业信息网，天风证券研究所

据中国电子专用设备工业协会统计，中国大陆 56 家主要半导体设备制造商 2020 年销售额为 242.90 亿元，同比增长 38.7%；总利润为 51.92 亿元，同比增长 80.5%。其中，集成电路设备总销售额为 96.77 亿元，同比增长 59.0%。国产设备不仅营收和利润快速上升，在创新层面也不断突破，例如北方华创的 12 英寸电感道等离子体干法金属刻蚀机、盛美股份的 3D 硅通孔电镀设备、中微股份的深紫外 LED MOCVD 设备等。

表 1：半导体设备领域国内外竞争厂商（按类别）

类别	外资品牌	国产品牌
光刻设备（含涂胶显影）	ASML、Nikon、Canon、TEL、DNS	上海微电子（光刻机）、沈阳芯源微（涂胶/显影机）
刻蚀设备	LAM、TEL、AMAT	中微半导体、北方华创
薄膜设备	AMAT、LAM、TEL	北方华创、沈阳拓荆
离子注入	AMAT、Axcelis	中科信、凯世通
过程控制	KLA、AMAT、日立	上海睿励、东方晶源
清洗设备	DNS、TEL、KLA、LAM	盛美半导体、至纯科技、北方华创、沈阳芯源微
化学机械研磨	AMAT、Ebara	华海清科、中电四十五所
测试设备	泰瑞达、爱德万	长川科技、精测电子等

资料来源：产业信息网，天风证券研究所

在全球半导体设备市场景气向上的背景下，其供应链相关企业有望受益。国内半导体设备企业实力的壮大，驱动国内半导体设备零部件产业的高速发展，零部件的国产化已然成为一种趋势。

1.2. 晶圆产能增加，设备零部件国产化进程持续推进

近半年以来，全球主力晶圆代工厂和 IDM 公布了新一轮扩产计划。缺芯大环境下，为满足市场需求，各晶圆代工厂加大扩产力度，资本支出也随之增加。目前，台积电、联电、格芯、中芯国际、世界先进、力积电这几家主要晶圆代工厂 2022 年资本支出合计达 548~588 亿美元，包括台积电公布资本开支 400-440 亿美元，联电 30 亿美元，格芯 45 亿美元，中芯国际达约 50 亿美元，世界先进 8.6 亿美元。

表 2：主要晶圆代工厂商 2022 资本支出

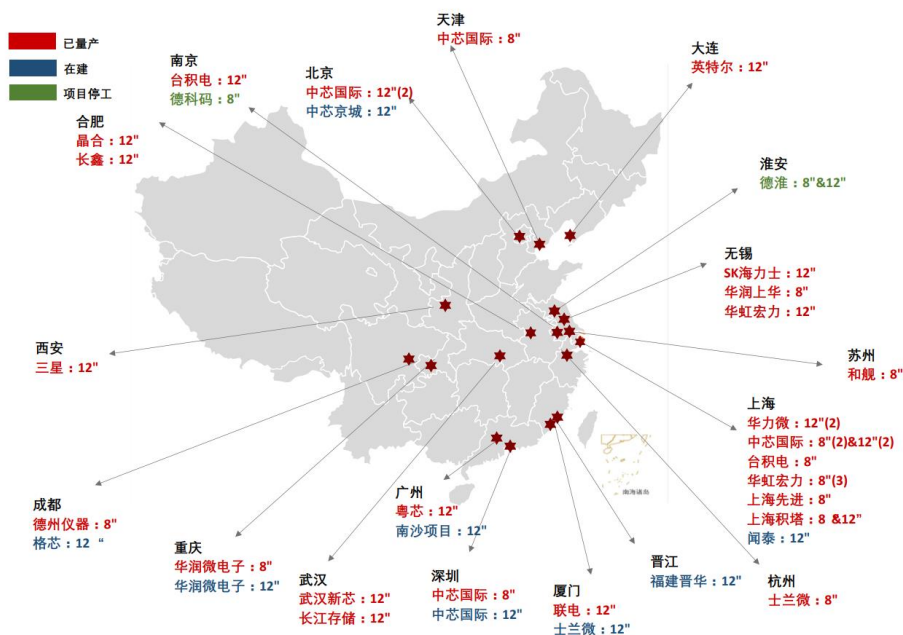
厂商	资本支出	主要用途
台积电	400 亿美元至 440 亿美元	70%至 80%将用于为最新和即将推出的节点（包括 N2、N3、N5 和 N7）建造新晶圆厂和扩大产能，10%至 20%将用于专业技术 花费，10%将用于先进封装
联电	30 亿美元	南科 Fab 12A P6 厂扩展计划，其中 90%将用于 12 英寸晶圆、10%用于 8 英寸晶圆产能
格芯	45 亿美元	扩充产能

中芯国际	约 50 亿美元	持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目
力积电	约 15 亿美元	铜锣厂相关投资, 其中 97%用于 12 英寸厂, 3%用于 8 英寸厂
世界先进	8.61 亿美元	75%用于晶圆五厂并购与扩产, 20%用于三厂, 5%用于其他厂区维修所需

资料来源: 全球半导体观察, 天风证券研究所

聚焦国内市场, 2020 年中国大陆半导体芯片市场规模为 1434 亿美元, 中国大陆半导体芯片产值约为 227 亿美元, 占比约 15.9%, 按照目前发展情况来看, 到 2025 年可能最多只能达到 20%, 远远落后于目标 70%。因此, 我们认为中国大陆晶圆厂商还有较大空间以提升自给率, 扩产势在必行, 晶圆厂对设备零部件的需求将持续增长。

图 5: 大陆半导体制造产能分布



资料来源: 中芯国际官网, 华虹半导体官网, 北京经济技术开发区官网, 中国电子报, 电子工程专辑, 华润微官网, 中国半导体行业协会, 中证网, 华力微官网, 第一财经, 上海先进官网, 闻泰科技官网, 士兰微官网, 央广网, 福布斯, 中国科技网, 集微网, 澎湃新闻, 中国经营网, 天风证券研究所

3月30日晚间, 据万业企业公告, 大基金二期与装备材料基金拟向公司参股子公司浙江锗芯分别增资 3.5 亿元与 0.4 亿元。本次增资后, 万业企业仍为浙江锗芯第一大股东, 持股 29.63%, 大基金二期持股 17.28%。

增资浙江锗芯是大基金首次布局半导体设备零部件领域, 意味着其对半导体零部件环节未来发展前景的看好和重视。通过深化与国内半导体设备企业的产业协同, 加速国产半导体零部件领域的突破与发展, 有助于打造更联动的本土半导体产业生态圈。

2. 上周半导体行情回顾

上周半导体行情跑输主要指数。上周申万半导体行业指数下降 3.32%, 同期创业板指数上涨 1.10%, 上证综指上涨 2.19%, 深证综指上涨 1.29%, 中小板指上涨 0.99%, 万得全 A 上涨 1.25%。

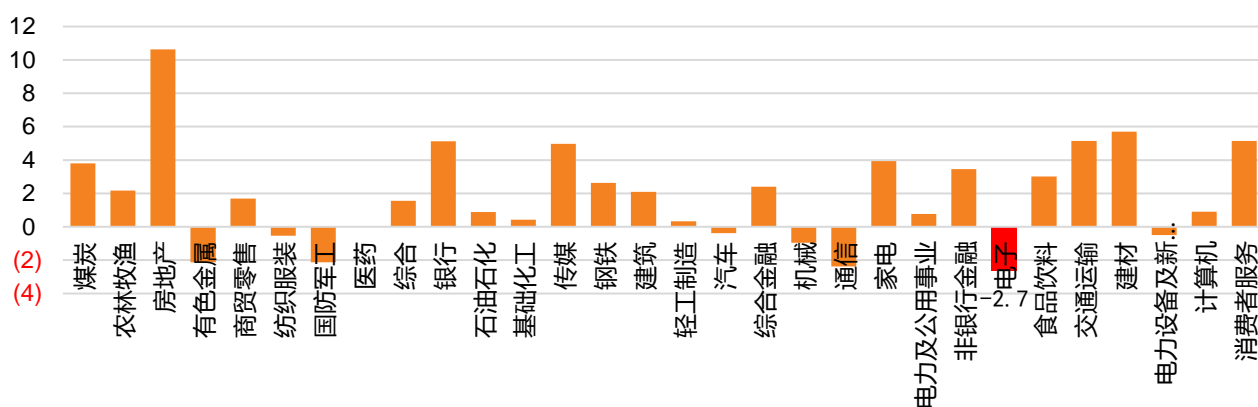
表 3: 上周半导体行情与主要指数对比

	上周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	1.10	-4.42
上证综合指数	2.19	-5.52

深证综合指数	1.29	-4.61
中小板指数	0.99	-4.32
万得全 A	1.25	-4.57
半导体（申万）	-3.32	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

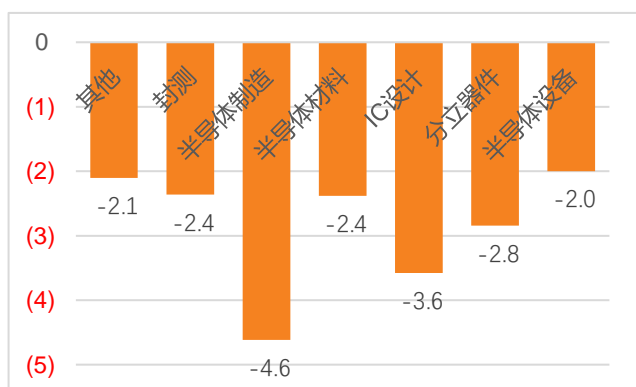
图 6：上周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

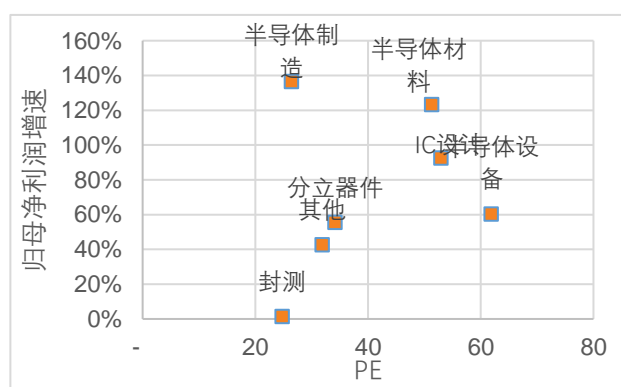
半导体各细分板块整体下跌。半导体细分板块中，半导体材料板块上周下跌 2.4%，分立器件板块上周下跌 2.8%，半导体设备板块上周下跌 2.0%，半导体制造板块上周下跌 4.6%，封测板块上周下跌 2.4%，IC 设计板块上周下跌 3.6%，其他板块上周下跌 2.1%。

图 7：上周子板块涨跌幅 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 8：半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源：Wind，天风证券研究所

上周半导体板块涨幅前 10 的个股为：复旦微电、有研新材、安集科技、综艺股份、法拉电子、国民技术、聚辰股份、紫光国微、斯达半导、至纯科技。

上周半导体板块跌幅前 10 的个股为：闻泰科技、芯朋微、飞凯材料、士兰微、新洁能、亚翔集成、景嘉微、思瑞浦、澜起科技、兆易创新。

表 4：上周涨跌前 10 半导体个股

股票名称	涨跌幅	股票名称	涨跌幅
复旦微电	19%	闻泰科技	-14%
有研新材	17%	芯朋微	-13%
安集科技	10%	飞凯材料	-12%
综艺股份	10%	士兰微	-11%
法拉电子	10%	新洁能	-11%
国民技术	8%	亚翔集成	-10%
聚辰股份	4%	景嘉微	-9%
紫光国微	3%	思瑞浦	-9%
斯达半导	3%	澜起科技	-8%
至纯科技	2%	兆易创新	-8%

资料来源：Wind，天风证券研究所

3. 上周重点公司公告

【中颖电子 688385.SH】

公司于 2022 年 03 月 29 日发布《中颖电子股份有限公司 2021 年年度报告》。公告称，报告期内，公司实现营业收入 14.94 亿元，同比快速增长 47.6%；归属于上市公司股东的净利润 3.71 亿元，同比大幅增长 77%。报告期内，客户需求强劲，但全球半导体供应链普遍性的产能紧张，导致公司产品供不应求，销售增长实际受限于公司能取得的上游产能。公司致力维持与上游代工伙伴的紧密合作，为保障取得上游代工产能的持续增长，公司支付了大额的长期产能预付款及保证金，这也体现了经营层对公司的长期展望极有信心。报告期内，家电及电机控制芯片销售占比近半，其次占比依序为锂电池管理芯片及 AMOLED 显示驱动芯片。公司 AMOLED 显示驱动芯片销售同比成长数倍，锂电池管理芯片销售同比成长逾倍，其他主要产品线并计则同比平稳增长。

【士兰微 600460.SH】

公司于 2022 年 03 月 29 日发布《杭州士兰微电子股份有限公司 2021 年年度报告》。公告称，2021 年，公司营业总收入为 719,415 万元，较 2020 年增长 68.07%；公司营业利润为 173,459 万元，比 2020 年增加 177,036 万元；公司利润总额为 173,058 万元，比 2020 年增加 176,830 万元；公司归属于母公司股东的净利润为 151,773 万元，比 2020 年增加 2145.25%。2021 年，公司营业利润和利润总额均扭亏为盈，主要是因为：（1）2021 年公司基本完成了年初制定的芯片制造和封装产能建设目标，公司产品持续在白电、通讯、工业、光伏、新能源汽车等高门槛市场取得突破；（2）2021 年公司子公司士兰集昕公司 8 英寸芯片生产线基本保持满产，并不断优化产品结构，产品综合毛利率提高至 20.70%，实现全年盈利；（3）2021 年公司持有的其他非流动金融资产增值较多。

【芯原股份 688521.SH】

公司于 2022 年 03 月 30 日发布《芯原微电子（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》。公告称，2021 年度，公司实现营业收入 21.39 亿元，同比增长 42.04%，其中半导体 IP 授权业务（包括知识产权授权使用费收入、特许权使用费收入）同比增长 20.81%，一站式芯片定制业务（包括芯片设计业务收入、量产业务收入）同比增长 55.51%。2021 年第四季度单季度实现营业收入 6.18 亿元，同比增长 38.86%。报告期内，公司消费电子领域实现营业收入 6.61 亿元，物联网领域实现营业收入 5.44 亿元，上述两类下游行业贡献的营业收入占比合计为 56.32%，占比较 2020 年度的 65.90%有所下降，主要由于公司数据处理、计算机及周边、汽车电子三类下游行业收入增速较高，分别为 102.42%、100.54%、56.17%。

【通富微电 002156.SZ】

公司于 2022 年 03 月 30 日发布《通富微电子股份有限公司 2021 年年度报告》。公告称，公司主要从事集成电路封装测试一体化服务。2021 年，是公司发展历程中浓墨重彩的一年，公司实现营业收入 158.12 亿元，同比增长 46.84%，在 2020 年百亿营收的基础上，继续实现大幅增长，公司市占率较 2020 年持续提升，营收规模继续排名全球行业第五位（数据来源：芯思想研究院）；公司盈利显著提升，2021 年实现净利润 9.66 亿元，同比增长 148.76%，创历史最高水平。2021 年，公司技术研发水平再创新高，公司作为主要参与完成单位、石磊总经理作为主要完成人的《高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺》项目喜获国家科技进步一等奖；公司承担的国家重大科技“02 专项”顺利收官；在先进封装方面公司已大规模生产 Chiplet 产品，7nm 产品已大规模量产，5nm 产品已完成研发即将量产，公司技术实力上升到一个前所未有的高度。

【南大光电 300346.SZ】

公司于 2022 年 03 月 31 日发布《江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年年度报告》。公告称，2021 年是公司“二次创业”转型成功的关键之年。培养全球产品服务单项冠军，是公司抢抓全球供应链调整机遇，深耕半导体材料产业链的基本战略。报告期内，公司以先进前驱体材料、电子特气和光刻胶三大半导体核心材料为主业的战略布局逐步完善，重大科技攻关项目实现重大突破，核心增长和业务协同效应凸现，市场和品牌形象大幅提升，主营收入和扣非净利润实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入 98,444.63 万元，同比增长 65.46%；归属于上市公司股东的净利润 13,622.66 万元，同比增长 56.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,042.00 万元，同比增长 3,225.70%。

【南大光电 300346.SZ】

公司于 2022 年 03 月 31 日发布《江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年第一季度业绩预告》。公告称，2021 年公司归母净利润预计 7,000 万元-8,300 万元，比上年同期增长 64.33%-94.85%；扣非净利润 5,400 万元-6,700 万元，比上年同期增长：67.57%-107.92%。业绩变动主要原因为（1）2022 年第一季度，公司主营收入和归母净利润继续保持高速增长。（2）MO 源业务在产能扩大、品质提升和毛利提高的基础上，通过技术创新不断优化产品和客户结构，逐步进入第三代半导体、IC 及光伏领域，市场份额稳步提升。（3）公司氫类电子特气紧跟市场和客户需求，进一步扩大产能，持续提升市场份额。（4）公司氟类电子特气市场仍然处于供不应求状态。（5）报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约 1,600 万元。

【中芯国际 688981.SH】

公司于 2022 年 03 月 31 日发布《中芯国际集成电路制造有限公司 2021 年年度报告》。公告称，报告期内，该集团实现主营业务收入 35,080.6 百万元，同比增加 30.0%。其中，晶圆代工业务营收为 32,134.3 百万元，同比增长 34.0%。报告期内各地区业务收入均实现增长。其中，中国内地及中国香港业务收入占主营业务收入的 64.0%；北美洲业务收入占主营业务收入的 22.3%；欧洲及亚洲业务收入占主营业务收入的 13.7%。在应用领域方面，智能手机类应用收入占晶圆代工业务营收的 32.2%；消费电子类应用收入占晶圆代工业务营收的 23.5%；智能家居类应用收入占晶圆代工业务营收的 12.8%；其他应用类收入占晶圆代工业务营收的 31.5%。在技术节点方面，来自 90 纳米及以下制程的晶圆代工业务营收的比例为 62.5%。其中，55/65 纳米技术的收入贡献比例为 29.2%，40/45 纳米技术的收入贡献比例为 15.0%，FinFET/28 纳米的收入贡献比例为 15.1%。

【中微公司 688012.SH】

公司于 2022 年 03 月 31 日发布《中微半导体设备(上海)股份有限公司 2021 年年度报告》。公告称,公司 2021 年营业收入为 31.08 亿元,较 2020 年增加约 8.35 亿元;2021 年毛利为 13.48 亿元,较 2020 年增加约 4.91 亿元,同比增加 57.38%,主要系:受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势,2021 年刻蚀设备收入为 20.04 亿元,较 2020 年增长约 55.44%,毛利率达到 44.32%;由于下游市场原因以及本年新签署的 MiniLED MOCVD 设备规模订单尚未确认收入,2021 年 MOCVD 设备收入为 5.03 亿元,较 2020 年增长约 1.53%,但 MOCVD 设备的毛利率达到 33.77%,较 2020 年的 18.65% 有大幅度提升。公司 2021 年新签订单金额为 41.3 亿元,较 2020 年增加约 19.6 亿元,同比增加约 90.5%。

【长电科技 600584.SH】

公司于 2022 年 03 月 31 日发布《江苏长电科技股份有限公司 2021 年年度报告》。公告称, (1) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24.87 亿元,较上年同期实现较大幅度增长,主要系报告期内,公司持续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域,整合提升全球资源效率,强化集团下各公司间的协同效应、技术能力和产能布局等举措,以更加匹配市场和客户需求,打造业绩长期稳定增长的长效机制,使公司各项运营积极向好。同时,来自于国际和国内客户的订单需求强劲,各工厂持续加大成本管控与营运费用管控,调整产品结构,全面推动盈利能力提升。(2) 经营活动产生的现金流量净额:主要系营收同比增长,销售回款增加,以及国内外各工厂运营管理能力的持续提升。(3) 归属于上市公司股东的净资产:主要系报告期公司完成非公开发行 A 股股票事项,募集资金到账,以及报告期业绩上升、盈利增长所致。(4) 基本每股收益:基本每股收益上升主要系收入增长,盈利能力提升。

【天岳先进 688234.SH】

公司于 2022 年 04 月 01 日发布《山东天岳先进科技股份有限公司 2021 年年度报告》。公告称,2021 年,公司实现营业总收入 49,385.68 万元,较上年同期增长 16.25%;实现归属于母公司所有者的净利润 8,995.15 万元,较上年同期增加 73,156.48 万元。根据 yole 报告统计,2021 年公司在半绝缘碳化硅衬底领域,市场占有率连续三年保持全球前三。同时,公司正加快提升导电型衬底产能建设。

【复旦微电 688385.SH】

公司于 2022 年 04 月 01 日发布《上海复旦微电子集团股份有限公司关于 2022 年度第一季度业绩预告的自愿性披露公告》。公告称:(1) 预计营业收入约为人民币 75,000.00 万元至 82,000.00 万元,与上年同期相比,将增加 24,798.89 万元至 31,798.89 万元,同比增加 49.40% 至 63.34%;(2) 预计实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币 19,500.00 万元至 25,000.00 万元,与上年同期相比,将增加 10,860.87 万元至 16,360.87 万元,同比增加 125.72% 至 189.38%;(3) 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为人民币 19,000.00 万元至 24,500.00 万元,与上年同期相比,将增加 11,880.37 万元至 17,380.37 万元,同比增加 166.87% 至 244.12%。

【中颖电子 688385.SH】

公司于 2022 年 04 月 01 日发布《中颖电子股份有限公司 2022 年第一季度业绩预告修正公告》。公告称,前次业绩预告情况为:预计 2022 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 10,137 万元—11,151 万元,扣除非经常性损益后的净利润为 10,101 万元—11,115 万元,基本每股收益 0.3301 元/股—0.3632 元/股。本次修正后为:预计 2022 年第一季度归属于上

市公司股东的净利润为 12,162 万元—13,176 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 10,300 万元—11,314 万元，基本每股收益 0.3961 元/股-0.4291 元/股。业绩预告修正主要系公司于 2022 年 3 月 31 日查收到政府发放的自主创新补贴款人民币 2,025 万元，导致非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的预计影响金额发生变动，2022 年第一季度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额由 36 万元调整为 1,862 万元。

4. 上周半导体重点新闻

中微公司收到兆驰股份 52 腔 MOCVD 设备采购订单。3 月 28 日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”）全资子公司南昌中微半导体设备有限公司（以下简称“南昌中微”）接到来自江西兆驰半导体有限公司 52 腔 PrismoUnimax®MOCVD 设备采购订单，签约仪式日前已于南昌高新区顺利举行。

台积电、三星呼吁美国 520 亿美元芯片补贴计划对外国公司开放。北京时间 3 月 28 日晚间消息，据报道，台积电和三星电子日前敦促美国政府，允许外国公司参与其 520 亿美元的半导体投资和补贴计划。上个月，美国众议院通过了《2022 年美国竞争法案》，其中包括 520 亿美元的半导体投资和补贴计划，以扩大美国本土芯片工厂建设，提升市场竞争力。作为全球最大的两家芯片代工厂商，台积电和三星电子均计划斥资数十亿美元，在美国建设新的尖端工厂。在回应“美国商务部要求提供信息以帮助规划和实施该计划”时，台积电表示：“基于公司总部所在地的任何偏袒和优待，并不是对拨款的有效或高效利用，也忽视了大多数领先半导体公司的公共所有权。”

国产首台自主研发的 8LP 双天车系统 SORTER 在终端客户成功通过认证。2022 年 3 月 28 日，由上海果纳半导体设备有限公司研发团队自主设计生产的国产首台 8LP 双天车系统的 sorter（晶圆传输设备），取得终端客户认证。晶圆传输设备在实现国产化的道路上再次获得技术突破；作为国内半导体传输设备制造的新锐企业，果纳由刚刚被评为“2022 最值得关注的女性创业者”之一的创始人叶莹女士的布局发展下，历经短短 1 年多的快速发展中，陆续获得国内多家知名半导体设备及制造企业的认可，团队以优质快速的服务响应，满足客户定制化的产品研发理念；不断攻克技术难题，对标国际先进水平，打破行业技术垄断，实现弯道超越。这是国产半导体产业良性发展的关键，同时代表着芯片行业细分领域国产自动化设备取得长足进展。

ASML 将于新加坡扩建新产线。IT 之家 3 月 29 日消息，光刻机巨头阿斯麦 ASML 在新加坡一间工厂的开幕式上宣布，将在该工厂兴建第二座制造车间，预计将于 2023 年初投产。扩建后的工厂将让该公司在新加坡的产能增加 3 倍，全球产能倍增。ASML 是世界领先的科技公司之一，全球半导体价值链的主要参与者。这里设计的技术和机器有助于在新加坡、韩国或美国生产芯片。世界上最大的芯片制造商们都需要这种设备。在生产处理器芯片的过程中，EUV 光刻机最昂贵。目前全世界只有阿斯麦（ASML）能制造出 EUV 光刻机。在过去的十年时间里，阿斯麦总共售出大约 140 套 EUV 光刻机，现在每一套系统的成本高达 2 亿美元。其新一代高数值孔径（HighNA）光刻机的价格将超过 3 亿美元。

华虹半导体发布二零二一全年业绩公告。华虹半导体有限公司 3 月 30 日宣布公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的综合业绩。摘要如下：销售收入创历史新高，达 16.308 亿美元，较上年度增长 69.6%。毛利率为 27.7%，较二零二零年上升 3.3 个百分点，主要由于平均销售价格上涨，产能利用率提升以及产品组合优化，部分被折旧费用增加所抵消。净利润为 2.310 亿美元，较二零二零年上升 593.3%。母公司拥有人应占年内溢利为 2.615 亿美元，较二零二零年上升 162.9%。基本每股盈利为 0.201 美元，较二零二零年上升 161.0%。净资产收益率为 9.7%，较二零二零年上升 5.5 个百分点。经营活动所得现金流量净额为 5.185 亿美元，较二零二零年上升 92.7%。月产能由 223,000 片增至 313,000 片 8 英寸等值

晶圆。付运晶圆（8英寸等值晶圆）由 2,191,000 片增至 3,328,000 片。

英特尔战略投资威兆半导体。3月31日，英特尔资本对外投资了一家中国功率半导体芯片设计公司——深圳市威兆半导体有限公司（下称“威兆半导体”）。威兆半导体此前已获得OPPO、小米、华勤技术、元禾璞华、动平衡等多家产业和专业机构战略投资，并在2021年7月获得国家级专精特新“小巨人”企业认定。据悉，本次英特尔资本投资的资金将继续用于威兆半导体研发技术、供应链技术、品质管理、技术行销等四大半导体设计公司核心能力提升，用于相关的高端人才引入和硬件设施投入。

士兰微：12吋线2期预计今年四季度投产。4月1日，士兰微在机构投资者调研活动中称，年报中提到的2022年营收目标100亿左右，主要增长点是IPM模块、PIM模块、MEMS传感器、AC-DC电路、DC-DC电路、手机快充芯片、PoE电路、IGBT、MOSFET、FRD等产品。SiC目前还是中试线。公司已着手在厦门士兰明镓公司建设一条6吋SiC功率器件芯片生产线，预计在今年三季度实现通线。12吋线2期预计在今年四季度投产，设备目前正在陆续到达。预计在2022年底前实现6万片/月的生产能力。第二条12吋线目前没有计划。

5. 风险提示

疫情继续恶化、产业政策变化、国际贸易争端加剧、下游行业需求不及预期。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房 邮编：570102 电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com